

住友金属工業(株) 中央技術研究所 松尾 亨

I 緒言

溶鉄の脱Cu法としては、溶鉄段階で Na_2SO_4 あるいは Na_2S を用いる方法が、脱Sn法としては CaC_2 を用いる方法が知られており、また 10^{-3}mmHg 程度の高真空処理すれば Cu, Sn が同時に除去できると報告されている。³⁾ しかしながら、これらの方はまだ実用化には到っていないようである。今回、プラズマによる溶鉄の脱Cu脱Sn法について調査したので報告する。

II 実験方法

実験は小型直流アーケープラズマ炉を用い、底部にアノードをもつ MgO ルッボ内で溶鉄 1.5 kg ($\text{C} 0.01 \sim 3.6\%$, $\text{Cu} 0.4\%$, $\text{Sn} 0.06\%$)を溶解・精錬するという方法で行なった。用いたプラズマガスは、10~40% $\text{H}_2\text{-Ar}$ であり、その使用量は 5~10 l/min である。なお比較のために Ar も用いた。雰囲気圧は大気圧下と 100~150 mmHg の減圧下の 2 水準とした。

III 実験結果と考察

- Fig.1, 2 に示すように、Ar プラズマでは脱Cu・脱Sn 共ほとんど進行しなかったが、 $\text{H}_2\text{-Ar}$ プラズマでは良好な脱Cu・脱Snが進行した。
 - 大気圧下よりも、減圧下の方が脱Cu・脱Sn 共良好であった。
 - プラズマガスが一定の場合、水素の割合が増加するにつれて、またプラズマガスの水素割合が同じであれば、ガス流量が増えるにつれて脱Cu・脱Sn の進行が向上した。
 - 脱Cu・脱Sn 共、 $[\text{C}]$ が高い方が若干良好である程度で、 $[\text{C}]$ の影響はあまり大きくなかった。
- Fig.3 に示すように、 $\log[\text{Cu}]$ あるいは $\log[\text{Sn}]$ と時間 t が直線関係を示すことおよび、ダスト中に Cu, Sn が多く含まれている（たとえば $\text{Cu}=8\%$, $\text{Sn} 0.4\%$ ）ことから、本脱Cu・脱Sn は、プラズマによって過飽和に溶解した水素が溶鉄から抜ける時に、Cu・Sn の蒸発を促進したものと考えられる。

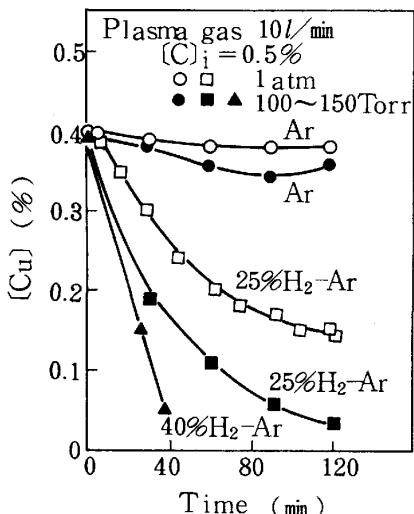


Fig.1. Removal of copper with $\text{H}_2\text{-Ar}$ plasma.

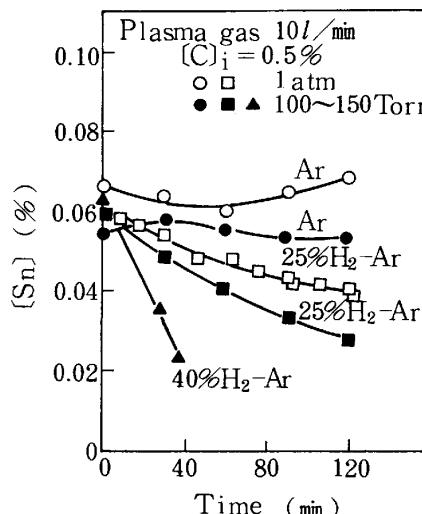


Fig.2. Removal of tin with $\text{H}_2\text{-Ar}$ plasma.

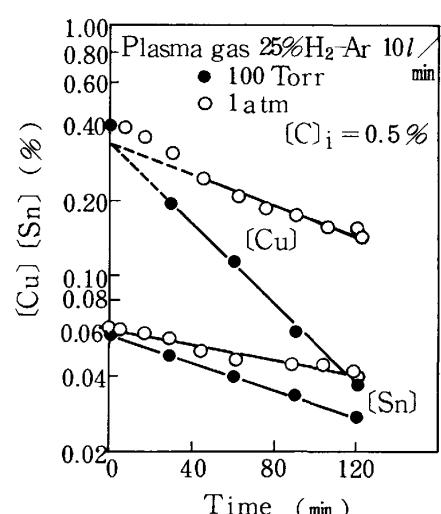


Fig.3. Relation between $\log [\text{Cu}], \log [\text{Sn}]$, and time.

1) F. C. Langenberg et al : Blast Furnace and Steel plant, 43(1955), 1142

2) 北村, 竹之内, 鈴木: 鉄と鋼, 67(1981) S 130

3) G. M. Gill et al : JISI, 191(1959), 172